

Technisches Datenblatt

EtroX[®] I CM UHT natur - ASTM

Typische Eigenschaften

- Ausgezeichnete thermo-oxidative Stabilität (Verwendung bis 300°C)
- hohe Wärmeformbeständigkeit
- Außergewöhnlich hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr geringe Kriechneigung
- Nahezu keine Feuchtigkeitsaufnahme

Typische Industrien

- Halbleiterindustrie
- Elektronik
- Semiconductor Back-End-Anwendungen
- Semiconductor Wafer Handling
- Semiconductor Hohe und tiefe Temperatur

	Testverfahren	Einheit	Wert
Allgemeine Eigenschaften			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1.43
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62 (23°C / 24h)	%	0.06
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62 (23°C / 48h)	%	0.1
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62 (23°C / 3 Weeks)	%	0.4
Mechanische Eigenschaften			
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	4
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	4800
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527	MPa	142
Schlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	40
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	3
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	90
Druckmodul	DIN EN ISO 604	MPa	4000
Thermische Eigenschaften			
Glasübergangstemperatur	ISO 11357-3	°C	270
Temp. of deflection under load, 1.80 MPa	ISO 75-1/-2	°C	265
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa	ISO 75-1/-2	°C	304
Elektrische Eigenschaften			



	Testverfahren	Einheit	Wert
Durchgangswiderstand	DIN EN 62631-3-1	$\Omega \cdot \text{cm}$	$>10^{11}$
Dielektrizitätskonstante (1 MHz)	DIN EN IEC 62631-2-1		3.3

